



Hoofd

Range of product	Modicon M580
Product or component type	Redundante processormodule
Impregnatiemateriaal	Conforme coating

Complementair

Aantal rekken	1
Toepassingsspecifieke I/O	Nauwkeurige tijdstempel HART Teller SSI encoder Seriële verbinding Bewegingssturing
Controles	Procesbesturing
Besturingskanalen	Programmeerbare lussen
Geïntegreerd aansluitingstype	1 Ethernet TCP/IP voor service poort 2 Ethernet TCP/IP voor apparaat netwerk USB type mini B 1 Ethernet voor HSBY poort
Aantal I/O-stations op afstand	16 - 2 rekken per X80 en Quantum drops
Aantal digitale I/O	64
Communicatiemodule processor	8 AS interface module 16 Ethernet-communicatiemodule
Communicatiedienst	DIO scanner RIO scanner
Geheugenbeschrijving	Uitbreidbaar flash, 4 GB voor gegevensopslag Geïntegreerd RAM, 10 kB voor systeem geheugen Geïntegreerd RAM, 16 MB voor programma Geïntegreerd RAM, 2048 kB voor gegevens
Applicatiestructuur	1 periodieke snelle taak 1 cyclische/periodieke mastertaak
Aantal instructies per ms	30 Kinst/ms 65% booleaans + 35% vast rekenkundig 40 Kinst/ms 100% booleaans
Stroomverbruik	360 mA bij 24 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	650000 H
Markering	CE

Omgeving

Trilling bestendigheid	3 gn
Schokbestendigheid	30 gn
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m 2000...5000 m met

Relatieve vochtigheid	5...95 % bij 55 °C zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/34/EU - ATEX-richtlijn
Productcertificaten	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Scheepvaart[RETURN] zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22
Normen	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G IEC 60079-0
Milieu-eigenschappen	Gasbestendig klasse Gx conform aan ISA S71.04 Gasbestendig class 3C4 conform aan IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zandbestendig class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zoutbestendig niveau 2 conform aan IEC 68252 Schimmelbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Sporenbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2
Beschermende behandeling	Conforme coating
Voeding	Interne voeding via rack
Status LED	1 LED (groen) processor loopt (RUN) 1 LED (rood) processor of systeemfout (ERR) 1 LED (rood) fout I/O module (I/O) 1 LED (groen) bezig met downloaden (DL) 1 LED (rood) fout op geheugenkaart of CPU flash (back up) 1 LED (groen/rood) ETH MS (configuratie Ethernet poort status) 1 LED (groen/rood) Eth NS (Ethernet netwerk status) 1 LED (groen) peer processor running (REMOTE RUN) 1 LED (groen) processor ID ingesteld op A (A) 1 LED (groen) processor ID ingesteld op B (B) 1 LED (groen) processor werkend als Primary (PRIM) 1 LED (groen) processor werkend als Standby (STBY) 1 LED (groen) I/O waarde overschreven door gebruiker (FORCED IO) 1 LED (groen) Hot standby link status (Hsby Diag)
Net weight	0,849 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	25,300 cm
Package 1 Weight	889,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,847 kg

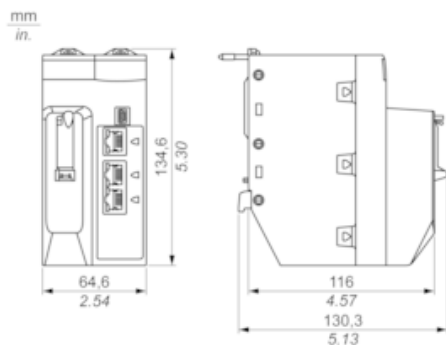
Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product

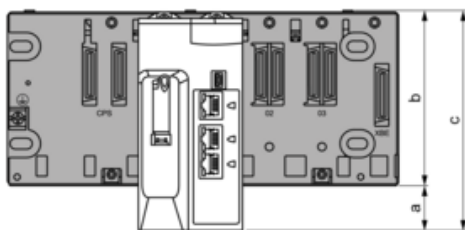


Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Nur CPU-Module

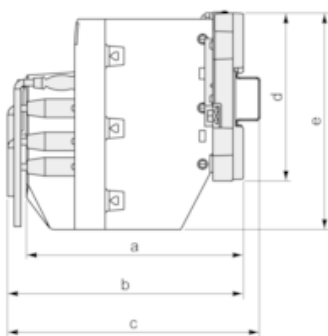


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.) Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Haupttracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienenlänge: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)